

**第1章 総論**

- 1.1 エンプラの位置づけ
- 1.2 エンプラ開発の歴史
- 1.3 エンプラの市場動向
- 1.4 各種エンプラの比較
- 1.5 最近のプラスチック関連の技術動向

【樹脂各論】

**第2章 汎用エンジニアリングプラスチック**

【エンプラ各論 2章・3章・4章の項目】

- (1) 概要（製法・特徴・物性・メーカー等）
- (2) 需給動向・需要予測  
（日本、中国、世界の需給動向）
- (3) 分野別市場・用途動向
- (4) 分野別の用途例（開発製品の写真と解説）
- (5) 技術開発動向（材料技術、成形技術）
- (6) メーカー各社の生産動向と増産計画

- 2.1 PC（ポリカーボネート）
- 2.2 PA（ポリアミド：汎用系（PA6、PA66、PAMXD6 など）
- 2.3 POM（ポリアセタール）
- 2.4 PBT（ポリブチレンテレフタレート）
- 2.5 強化PET（強化ポリエチレンテレフタレート）
- 2.6 m-PPE（変性ポリフェニレンエーテル）

**第3章 スーパーエンジニアリングプラスチック**

- 3.1 FR（ふっ素樹脂）
- 3.2 PPS（ポリフェニレンスルファイド）
- 3.3 LCP（液晶ポリマー）
- 3.4 PAR（ポリアリレート）
- 3.5 HTPA（高耐熱ポリアミド：PA6T、PA9T、PA10T、PA46 など）
- 3.6 PSU（ポリスルホン）
- 3.7 PES（ポリエーテルスルホン）
- 3.8 PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）
- 3.9 PEI（ポリエーテルイミド）
- 3.10 PAI（ポリアミドイミド）
- 3.11 TPI（熱可塑性ポリイミド）
- 3.12 SPS（シンジオタクチックポリスチレン）

**第4章 その他エンジニアリングプラスチック系材料**

- 4.1 LCPA（長鎖ポリアミド：PA11、PA12、PA1010、PA1012 など）
- 4.2 TPC（ポリエステル系熱可塑性エラストマー）

【分野別・用途別の製品】

**第5章 分野別・用途別の製品動向**

【5章の分野別・用途別の製品動向の項目】

- (1) はじめに
- (2) 各部位における要求特性
- (3) 部位別の具体的な用途例と採用されたエンプラ
- (4) 部位別の具体的な用途例の写真と解説

- 5.1 自動車・車輻分野
- 5.2 電気・電子分野
- 5.3 各種機械分野
- 5.4 医療関連分野
- 5.5 その他分野

【メーカー情報】

**第6章 メーカーおよび関連企業**

【6章のメーカーおよび関連企業の項目】

- (1) 品揃え
- (2) 生産・販売体制  
1) 生産拠点 2) 販売拠点 3) カスタマーラボの拠点

- 6.1 旭化成
- 6.2 AGC
- 6.3 ARKEMA
- 6.4 EMS-GRIVORY
- 6.5 出光興産
- 6.6 上野製薬
- 6.7 宇部興産
- 6.8 クラレ
- 6.9 クレハ
- 6.10 SABIC Innovative Plastics(SABIC IP)
- 6.11 JXTG エネルギー
- 6.12 住化ポリカーボネート
- 6.13 住友化学
- 6.14 セラニーズ
- 6.15 DSM Engineering Plastics
- 6.16 ソルベイスペシャルティポリマーズジャパン
- 6.17 ダイキン工業
- 6.18 ダイセル・エポニック
- 6.19 ダイセルポリマー
- 6.20 帝人
- 6.21 DIC
- 6.22 DuPont
- 6.23 東ソー
- 6.24 東レ
- 6.25 東レ・デュポン（TDC）
- 6.26 東洋紡
- 6.27 Covestro
- 6.28 BASF
- 6.29 ビクトレックス
- 6.30 ポリプラスチック
- 6.31 三井化学
- 6.32 三井・ケマーズ フロロプロダクツ
- 6.33 三菱エンジニアリングプラスチック(MEP)
- 6.34 三菱ケミカル
- 6.35 ユニチカ
- 6.36 LANXESS